

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（券商组织的策略会）
参与单位名称	上证路演中心的投资者 华创证券、招商证券 国盛证券、开源证券、国寿安保基金、淳厚基金、平安基金、水濮私募 国金证券、工银安盛、上海电气自营、彤源投资、国泰海通、恒越基金、国信证券自营、银鼎基金、银河证券自营、利位投资、天演论集团、东海证券自营、国信弘盛、南华基金、宽格投资、兆顺基金、长江资管、尚信资产、人保资管、农银汇理、圆信永丰基金、民生基金、长安基金、天演论投资、昊晟基金、宏鼎财富、中海基金、宏桥控股、瀛赐基金 摩旗投资、复星集团、太平洋保险、中信保诚基金、友邦资管 东北证券、华福证券、平安资管、申万菱信、正鑫基金、辛格资本、拾贝投资、周期投资、德邦基金、个人投资者 方正证券、杭州星禾、天弘基金、致合资管、赛富基金、核心资本 淡水泉投资 部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间及地点	9月7日（上证路演中心）09:00-10:00；（嘉兴沃尔德）14:00-15:00 9月8日（嘉兴沃尔德）10:30-12:00； 9月10日（上海）10:30-11:30；12:00-13:00 9月11日（嘉兴沃尔德）10:00-11:00；（杭州）13:30-14:30；14:30-15:30
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈继锋 独立董事：江霞 副总经理、董事会秘书：陈焕超 副总经理、财务总监：许伟 证券事务代表/IR：沈李思
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示： 1、新产品、新项目从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓

绍

慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素；同时需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资，以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期，无法如期为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。特此郑重提醒广大投资者防范公司相关新业务的投资风险！

2、如涉及对行业预测/判断、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险！

Q、请问金刚石微钻在 PCB 板领域的工艺验证和订单获取进展如何？

目前，公司已与多家 PCB 厂商持续开展产品优化与验证工作，其中部分客户已进入商务谈判流程。公司同步推进产能建设，为后续订单交付做好准备。该业务目前尚处市场拓展初期，对公司当期业绩影响有限，请投资者注意投资风险。

Q、公司 2026 年上半年营收与利润变动的核心驱动因素是什么？

2026 年上半年，公司营收与利润变动主要来自两大板块：一是精密工具业务，刀具板块依托新能源装备、消费电子等下游市场拓展，同比增长 21.64%；二是金刚石功能部件业务部分产品实现规模化量产，其中 CVD 钻石声学振膜实现营收 999.60 万元，同比增长 4143.75%；三是部分子公司实现扭亏为盈。

Q、请问超硬刀具业务的下游需求结构有变化吗，目前主要服务哪些行业客户？

今年上半年超硬刀具业务的下游需求结构未发生较大变化，目前主要服务新能源装备、消费电子、通用机械等领域。

Q: 公司在金刚石功能材料领域技术水平?

1、布局早、积淀深。公司自成立起即布局 CVD 金刚石材料的研发及功能化应用，已实现从基础材料生长到高端功能化应用的技术闭环，具备长期的技术研发历史和丰富的经验积累。

2、全流程规模化制造能力。公司并非单一环节的金剛石材料或加工企业，已构建从装备设计、晶体生长到精密加工的全流程制造能力，对核心工艺参数能够实现精准调控。

	3、关键工艺自主可控。在晶体生长端，公司自主掌握大腔室 HFCVD 装备设计与热场/流场均匀性调控技术，以及大功率 MPCVD 制备高质量大面积金刚石热沉材料的沉积工艺，保障材料的高可靠性与大尺寸生长能力；在精密加工端，突破了超薄金刚石微纳米切割、超高精密研磨与镜面抛光技术，可稳定实现极低的表面粗糙度与总厚度偏差，满足半导体级的平坦度要求。 4、知识产权与多学科支撑。公司在金刚石膜声学器件、金刚石热管理部件、硼掺杂金刚石膜涂层电极、金刚石光学窗口等“声、热、电、光”维度均具备技术积淀，已布局多项核心专利，形成严密的知识产权护城河；这一多学科交叉的技术底蕴，将为本项目投产后的技术迭代、良率爬坡、成本控制及规模化量产提供重要支撑。 Q：公司金刚石功能材料业务在散热方面的应用进展情况？ 公司重点解决高端 GPU/CPU、光通信芯片等近结散热痛点，应对国内外高端算力芯片散热需求。 在市场验证方面，公司积累了多家优质行业头部客户资源，已与海内外头部 GPU/CPU 芯片设计厂商、晶圆代工龙头及先进封测巨头开展深度技术对接与产品送样验证等。 面向 C2W 的中小尺寸金刚石散热衬底，公司已打通从 MPCVD 高速生长到超高精密研抛的全链条工艺，实现了键合级衬底的高效制备，正向产业化落地迈进。 面向 W2W 领域的 4-12 英寸金刚石散热晶圆，特别是 12 英寸金刚石散热晶圆已实现高平整度、高良率的稳定生长，已与多家行业头部企业进行深度研发合作，目前处于小批量验证阶段。 截至目前，金刚石散热相关业务已实现小部分营业收入，但该收入目前占公司总体营业收入比例较小，最终产品能否在客户验证成功具有一定的不确定性，距离规模化收入尚有较大差距，预计对 2026 年度营业收入贡献有限。敬请广大投资者客观认识该业务的产业化进程，注意投资风险。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 11 日